

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; активная задняя шина (12 слотов) для установки модулей S7-1500, горячая замена модулей для ET 200MP с IM 155-5 PN HF (начиная с FW V4.4.1); профильная шина S7-1500 и крышки слотов должны быть заказаны отдельно



Общая информация

Обозначение типа продукта	Активная задняя объединительная панель ST, 1+12, слотов
Функциональный стандарт HW	FS01
Версия микропрограммного обеспечения	V1.0.0
• Возможно обновление микропрограммного обеспечения	Да

Функция продукта	
• Данные для идентификации и техобслуживания	Да; I&M0 - I&M3
• Режим тактовой синхронизации	Да
• Пуск согласно приоритету	Да

Инженерное обеспечение с помощью	
• STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	V16
• STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	с V5.6
• PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision	V2.34 / -

Мощность	
Потребляемая мощность шины на задней стенке	2 W

Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	2 W

Конфигурация аппаратного обеспечения

Гнезда	
• Размер раstra	35 mm; Возможно использование модулей шириной 25 mm
• Число гнезд	13
— в т. ч. для CPU, макс.	0
— в т. ч. для IM, макс.	1
— в т. ч. для PS, макс.	12; макс. 2 PROFI-safe на подстанцию
— в т. ч. для IO/CM/CP/TM, макс.	12
— в т. ч. для F-IO, макс.	12
• Макс. число гнезд одинарной ширины	12

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации	
• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	40 °C

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C

Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря,	5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 m, см.

макс.	техническое описание
Размеры	
Ширина	434 mm
Высота	99 mm
Глубина	14 mm
Массы	
Масса, прибл.	352 g
последнее изменение:	19.08.2021 